



Fraunhofer
ENAS

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR
ELEKTRONISCHE NANOSYSTEME ENAS

**16. CHEMNITZER SEMINAR
„SPECIAL PACKAGING SOLUTIONS“
UND WORKSHOP “WAFERBONDEN”**



25. UND 26. JUNI 2013

Fraunhofer ENAS |
Technologie-Campus 3 |
09126 Chemnitz

16. CHEMNITZER SEMINAR „SPECIAL PACKAGING SOLUTIONS“

DIENSTAG, 25. JUNI 2013

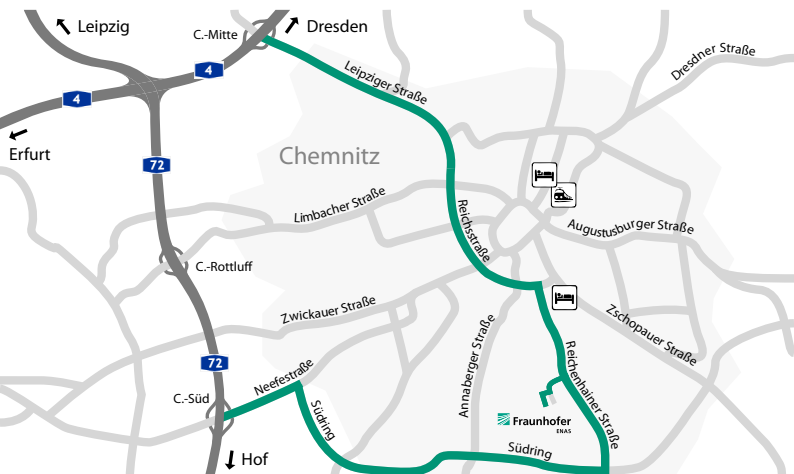
13:00 – 13:10 Uhr	Dr. Maik Wiemer, Fraunhofer ENAS Begrüßung
13:10 – 13:40 Uhr	Prof. Tim Weihs, Johns Hopkins University „Rapid, Room-Temperature Bonding of Small and Large Components with Reactive Materials“
13:40 – 14:10 Uhr	Michael Görtz, Fraunhofer IMS „Verbesserung der Lebensqualität durch intelligente Humanimplantate“
14:10 – 14:40 Uhr	Dr. Reiner Götzen, microTEC „Additiv von der Mikrostruktur zum Mikrosystem“
14:40 – 15:10 Uhr	Diskussionspause
15:10 – 15:40 Uhr	Dr. Roy Knechtel, X-FAB „Wafer Level Packaging Concepts based on Glass Frit and Metal Bonding“
15:40 – 16:10 Uhr	Uwe Wilkens, Schott AG „SCHOTT MEMpax – ultra dünnes Glas für die Mikroelektronik“
16:10 – 16:40 Uhr	Tobias Seifert, Fraunhofer ENAS „Printing Technologies as Tool in Advanced System Packaging“
17:00 Uhr	Ende der Veranstaltung

WORKSHOP „WAFERBONDEN“

MITTWOCH, 26. JUNI 2013

09:00 – 09:10 Uhr	Dr. Maik Wiemer, Fraunhofer ENAS Begrüßung
09:10 – 09:40 Uhr	Dr. Steffen Ziesche, Fraunhofer IKTS Dresden „Herstellung hybrider 3D-Mikrostrukturen mittels Mehrlagenkeramiktechnologie“
09:40 – 10:10 Uhr	Dr. Thomas Dietrich / Andreas Freitag, microTEC „Raumtemperaturbonden von optisch transparenten Materialien mithilfe von Lasern“
10:10 – 10:40 Uhr	Dr. Werner Weber, Infineon Technologies „3D Stacking of Silicon Chips – An Industrial Viewpoint“
10:40 – 11:10 Uhr	Diskussionspause
11:10 – 11:40 Uhr	Herr Gerald Mittendorfer, EVG „Recent Status on Low-Temperature Cu-Cu Waferbonding“
11:40 – 12:10 Uhr	Wei-Shan Wang, Fraunhofer ENAS „Substrate Bonding at Low Temperature by using Nanoporous Gold“
12:10 – 12:40 Uhr	Christian Bauer, EPCOS AG „Waferbonding-Technologies for Wafer-Level-Packages of SAW-Components“
12:40 – 13:10 Uhr	Mittagsimbiss
13:10 – 13:40 Uhr	Dr. Sebastian Brand, Fraunhofer IWM Halle, Dr. Peter Czurratis, PVA Tepla Analytical Systems GmbH „Defektanalyse in wafergebondeten Grenzflächen mittels akustischer Inspektion“
13:40 – 14:10 Uhr	Dr. Oliver Treichel, SUSS MicroTec Lithography GmbH „Eutektische Bondverfahren auf Wafer-level für MEMS und LED“
14:40 Uhr	Ende der Veranstaltung

KONTAKT UND ANFAHRT



Fraunhofer ENAS

Technologie-Campus 3, 09126 Chemnitz

(Anfahrt über Rosenbergstraße oder Fraunhoferstraße)

Tel.: +49 371 45001-0

Fax: +49 371 45001-101

info@enas.fraunhofer.de

www.enas.fraunhofer.de

Anmeldung:

Senden Sie bitte Ihre Anmeldung bis 15. Juni 2013 an:

undine.weltsch@enas.fraunhofer.de